

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: 天津工場MAPBGA製品のモールド材をG760からG760Lへ変更の件

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2013年10月7日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

Japan Regional Marketing

該当GPCN番号:

15843

変更内容:

MC9328MX, MC/SC1321X 天津工場MAPBGA製品のモールド材をG760からG760Lへ変更

変更理由:

対象製品:

MC13211
MC13211R2
MC13212
MC13212R2
MC13213
MC13213R2
MC9328MX1CVM15
MC9328MX1CVM15R2
MC9328MX1DVM15
MC9328MX1DVM15R2
MC9328MX1DVM20
MC9328MX1DVM20R2
MC9328MX1VM20
MC9328MXLCVM15
MC9328MXLCVM15R2
MC9328MXLCVP15
MC9328MXLDVM15
MC9328MXLDVM15R2
MC9328MXLDVM20
MC9328MXLDVP15
MC9328MXLDVP15R2
MC9328MXLDVP20
MC9328MXLDVP20R2
MC9328MXLVM15
MC9328MXLVM15R2
MC9328MXLVM20
MC9328MXLVM20R2
MC9328MXLVP15
MC9328MXLVP15R2
MC9328MXLVP20
MC9328MXLVP20R2
MC9328MXSCVP10
MC9328MXSCVP10R2
MC9328MXSVP10

MC9328MXSVP10R2
SC13213C
SC13213CR2

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日： 22-Dec-2013

変更品の見分け方:

その他:

形状、機能は変更ありません。
FIT値、信頼性について信頼性試験にて確認してまいります。
11/8以降に提示予定です